

证券代码：301269

证券简称：华大九天 编号：2025-002

北京华大九天科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	线上参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2025 年 5 月 20 日 16:00-17:00
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)
上市公司接待人员姓名	董事长：刘伟平先生 独立董事：吴革先生 副总经理、财务负责人：刘二明先生 副总经理、董事会秘书：宋鑫林先生 保荐代表人：何洋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司担负国家 EDA 技术攻关任务，目前取得哪些突破和进展，公司预计什么时候实现真正意义全流程突破？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司目前 EDA 工具软件产品和服务覆盖模拟电路设计、存储电路设计、射频电路设计、数字电路设计、平板显示电路设计、晶圆制造、先进封装设计和 3DIC 设计等领域。其中，模拟电路设计全流程 EDA 工具系统是全球领先的模拟电路设计全流程 EDA 解决方案之一；存储电路设计全流程 EDA 工具系统是国内领先的存储电路设计全流程解决方案；射频电路设计全流程 EDA 工具系统是国内唯一的射频电路设计全流程 EDA 工具系统；平板显示电路设计全流程 EDA 工具系统是全球领先的商业化全流程设计系统，多项技术达到国际</p>

领先水平，填补了国内平板设计 EDA 专业软件的空白；数字电路和晶圆制造等方面的部分工具也具有独特的技术优势，部分工具达到国际领先水平；先进封装设计关键解决方案、3DIC 设计 EDA 工具填补了该领域国内 EDA 工具的空白。公司始终以实现我国 EDA 自主发展为己任，将采取自主研发、合作开发和并购整合相结合的模式加速 EDA 全流程布局和核心技术的突破，加速 EDA 工具国产化进程，不断扩展市场份额。感谢您的关注！

2. 中国电子成为实控人后，在业务导入方面采取哪些具体措施，会不会有半导体资产注入可能？

答：尊敬的投资者您好，中国电子集团将依托自身在产业布局、资源获取、投资管理等方面的优势，通过资源导入等为公司业务发展赋能，提高公司资产质量，促进公司与中国电子集团及其下属企业在市场拓展、技术合作、产业链资源整合、公司治理及其他多个领域的协同性，以增强公司持续稳定经营能力和抗风险能力，进而提升公司价值及对股东的投资回报。同时，中国电子集团还将充分发挥自身资金优势、产业优势等，进一步加强对公司的产业投入及支持，包括业务导入、投资并购资源和资金支持、争取国家相关政策支持、协调地方政府关系等，继续支持公司现有主营业务持续发展，进一步增强公司现有主营业务的竞争实力。感谢您的关注！

3. 公司收购芯和半导体尽职调查和审计什么时间能够完成，初步收购预案什么时候能制定完毕？

答：尊敬的投资者您好，公司正按计划推进对芯和半导体的收购工作，关于收购进展情况，请您关注公司相关公告。感谢您的关注！

4. 华大九天作为国内 EDA 行业的龙头企业，近年来在技术研发和市场拓展方面取得了显著成绩。能否介绍一下公司在未来 3-5 年内的战略规划？

答：尊敬的投资者您好，公司致力于成为全流程、全领域、

全球领先的 EDA 提供商，为我国集成电路产业持续健康发展提供支撑和保障。公司希望，未来 3 年可以完成集成电路设计工具系统的开发和市场推广，全面实现设计类工具国产化替代，更多产品达到国际领先水平。同时与产业协同实现制造、封测工具全流程覆盖，支持国内最先进工艺；未来 5 年公司可以全面实现集成电路设计、制造和封测领域的 EDA 工具全流程国产化替代，多个产品达到国际领先水平，成为全球 EDA 行业的领导者。感谢您的关注！

5. 小米玄戒 O1 是华大九天提供的 eda 软件吗？

答：尊敬的投资者您好，公司与玄戒在内的国内主要集成电路设计企业建立了良好的业务合作关系。关于公司业务合作情况请参见定期报告、公司官方网站、公司微信公众号的相关信息，感谢您的关注！

6. 我们看到华大九天为台积电 EDA 厂商联盟，能否介绍一下公司与台积电的合作？

答：尊敬的投资者您好，公司是台积电 EDA 联盟的十六个成员之一。作为国产 EDA 领域的领军企业，公司在 EDA 工具方面具有优势，相关工具与台积电的工艺紧密结合，为共同客户提供从芯片设计到制造的解决方案。感谢您的关注！

7. 公司在晶圆制造 EDA 工具研发方面有哪些进展？

答：尊敬的投资者您好，公司根据晶圆制造厂的工艺开发和 IP 设计需求，提供了相关的晶圆制造 EDA 工具，在已有工具基础上，针对晶圆制造 EDA 的多个细分领域形成了多个解决方案，包括 PDK 套件开发方案、标准单元库和 SRAM 等基础 IP 的完整工具链支撑方案、光刻掩膜版数据准备和分析验证方案、物理规则验证和可制造性检查方案等，为晶圆制造厂提供了重要的工具和技术支撑。2024 年公司在物理验证工具 Argus 的基础上，新开发了多重掩膜版拆分功能 Layout Decomposer，为掩膜版图形的拆分提供了高性能的 EDA 解决方案；同时新推

出工艺诊断分析平台，对制造过程中的图形缺陷和良率降低分析提供全面支持。后续公司将采取自主研发、合作开发和并购整合相结合的模式加速全流程布局和核心技术的突破。感谢您的关注！

8. 公司股权激励实施情况，24 年股权支付费用是多少？

答:尊敬的投资者您好，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 12 月 18 日为首次授予日，以 51.22 元/股的价格向符合条件的 408 名激励对象授予 869.00 万股第二类限制性股票。公司于 2024 年 11 月 4 日召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意本次激励计划授予价格由 51.22 元/股调整为 51.07 元/股；同意以 2024 年 11 月 4 日为预留授予日，以 51.07 元/股的价格向符合条件的 186 名激励对象授予 217.00 万股第二类限制性股票。公司 24 年股份支付费用为 1.78 亿元。感谢您的关注！

9. 请问公司在数字电路设计 EDA 工具研发方面有哪些新突破和后续计划？

答:尊敬的投资者您好，公司的数字电路设计 EDA 工具为数字电路设计的部分环节提供了关键解决方案，已推出的商业化工具包括单元库特征化提取工具、存储器电路特征化提取工具、混合信号电路模块特征化提取工具、单元库/IP 质量验证工具、逻辑综合工具、时序功耗优化工具、高精度时序仿真分析工具、时钟质量检视与分析工具、版图集成与分析工具、大规模数字物理验证和大规模数字寄生参数提取工具等十余款。2024 年公司投资了上海阿卡思微电子有限公司，弥补了公司形

式验证工具的空白；同时新推出了基于 GPU 平台的单元库特征化提取工具 Liberal-GT，提取速度提升十余倍。后续公司将加快数字仿真工具、静态时序分析工具以及数字 EM/IR 分析工具的研发，丰富公司产品线，全面提升公司核心竞争力。感谢您的关注！

10. 在当前的财务状况下，如何在保证研发投入强度的同时，优化成本结构，提升公司盈利能力，实现研发投入与盈利增长之间更好的平衡？

答：尊敬的投资者您好，为确保自身的竞争力，公司保持了持续高比例的研发投入。2024 年公司研发费用 86,812.07 万元，占营业收入的比例为 71.02%。目前公司依旧处于补链强链阶段，维持较高的研发投入是必要的，预计未来一定时期内研发费用占营业收入比例仍将保持在较高水平。未来随着公司贯通各个全流程平台、技术不断成熟、市场份额逐步扩大，规模效应逐渐显现后，研发费用占营业收入比例有望逐渐降低。感谢您的关注！

11. 请介绍一下公司在中小投资者保护方面的具体措施？

答：尊敬的投资者您好，公司在中小投资者保护方面采取了多项举措。制度方面，制定《股东大会议事规则》《投资者关系管理制度》等，规范决策流程，保障股东参与权与监督权；信息披露方面，严格遵循法规要求，通过业绩说明会、互动易平台、热线电话、邮件等渠道，及时、准确、全面地向投资者传递公司经营、财务及战略信息，回应投资者关注问题；股东大会环节，采用现场与网络投票结合的方式，保障中小股东表决权，并由律师全程监督，确保程序合法合规。感谢您的关注！

12. AI 已经在各行业广泛应用，请问 EDA 与 AI 有什么融合？

答：尊敬的投资者您好，AI 技术和 EDA 是双向赋能的关系。一方面，AI 算法的应用使得 EDA 工具在芯片设计过程中能够更

加智能地处理复杂数据、优化布局布线、加速仿真验证等环节，从而显著提升设计效率和质量；另一方面，EDA 技术也在为 AI 芯片的设计提供强大支持。随着 AI 应用的日益广泛，对 AI 芯片的性能要求也越来越高。EDA 工具通过提供高精度、高效率的设计方案，助力 AI 芯片在算力、能效比等方面实现突破。公司已经有多款工具应用了 AI 技术。2024 年公司新推出了设计自动化平台 Andes，该平台目前包括模拟设计自动化工具 Andes Analog 和功率管设计自动化工具 Andes Power。其中 Andes Power 在优化流程中深度融入了 AI 技术，进一步缩短优化时间，显著提升了电源芯片设计的效率和质量。感谢您的关注！

13. 您好，能否介绍一下公司和高校的合作情况？

答：尊敬的投资者您好，公司秉持开放合作的创新精神，深耕产学研领域，与多所顶尖高校及科研院所建立紧密的合作关系。截至 2024 年末，公司与复旦大学、北京大学、西安电子科技大学等高校建立 30 多个联合实验室，与中国科学院大学，西安交通大学等高校联合建立 EDA 硕士班，并录取了来自上海交通大学、复旦大学、北京航空航天大学的多名应届毕业博士生进站我司博士后科研工作站，培养了 200 多名硕博研究生及博士后。同时与中科院微电子所、上海交通大学、EDA 国创中心等多所科研院所及高校开展项目，聚焦专业领域和核心要点，共同攻克行业技术难题，不断巩固并扩大市场竞争优势，为行业持续注入活力。感谢您的关注！

14. 公司实控人对公司有什么具体支持措施？后续有没有增持或者回购公司股票的计划？

答：尊敬的投资者您好，公司 3 月 31 日发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买芯和半导体 100% 股份，并同步向中国电子集团、中电金投发行股份募集配套资金。中国电子集团拟通过定增方式为公司收购芯和半导体提供必要的资金支

持，是成为公司实际控制人后支持公司发展的具体措施之一。后续如有增持、回购等安排公司将依据法律法规要求进行披露。感谢您的关注！

15. 公司打算如何做市值管理工作？

答：尊敬的投资者您好，在制度方面，公司制定了《市值管理制度》，从制度层面规范市值管理行为，确保市值管理工作有章可循。同时，在《公司章程》中明确制定了利润分配政策，并结合公司实际情况，制定了上市后三年股东分红回报规划，以保障投资者的合理回报。在业绩方面，公司将持续优化经营，通过自主研发、合作开发和并购整合相结合的模式加速 EDA 全流程布局和核心技术的突破，加速 EDA 工具国产化进程，不断扩展市场份额，以长期、稳定、优良的业绩回报股东，吸引更多投资者关注与信赖。在投资者关系管理方面，公司重视与投资者的沟通交流，通过多种渠道与投资者进行沟通交流，如定期举办业绩说明会、接待投资者调研、接听投资者热线、回复投资者邮件等。感谢您的关注！

16. 公司在汽车电子方面有什么布局？

答：尊敬的投资者您好，在产品布局方面，公司原理图/版图编辑工具 Aether、电路仿真工具 ALPS、物理验证工具 Argus DRC/LVS、功率器件可靠性分析工具 Polas 和晶体管级电源完整性分析工具 Patron 均获得 ISO 26262 TCL3 和 IEC 61508 T2 国际标准认证证书，能够支持汽车安全完整性标准最高 ASIL D 级别的芯片设计；在行业标准制定方面，由公司牵头，联合行业多家单位共同制定了《车规级泛模拟集成电路电子设计自动化工具技术要求》（T/CESA 1384-2025）和《车规级平板显示电路电子设计自动化工具技术要求》（T/CESA 1385-2025），旨在为车规级 EDA 的开发和应用提供技术规范，填补国内相关领域标准空白，加速中国新能源汽车产业高质量发展。感谢您的关注！

附件清单	无
日期	2025 年 5 月 20 日